



PLASMA TECHNOLOGY SOLUTIONS

# NEO 2000

Массовое  
производство

Удаление  
резиста/декам

Очистка после  
имплантации

Травление



When plasma matters



PLASMA TECHNOLOGY SOLUTIONS

# NEO 2000

Установка плазменной обработки NEO 2000 от компании Trymax Semi Conductor является современной системой удаления фоторезиста, зачистки пластин и озонения. Система специально предназначена для обработки подложек диаметром до 200 мм. Она оснащена ультра-быстрой станцией загрузки, которая может быть адаптирована для обработки подложек любых размеров вплоть до 200 мм. Линейка NEO 2000 отвечает всем требованиям исследовательских институтов и производителей устройств, имеет компактный размер и высокую производительность, что позволяет максимально снизить эксплуатационные расходы.



## Характеристики

- 200/300 мм размер п/п пластин/подложек
- 3 или 4 касетные станции или два встроенных порта SMIF
- Пятиосевое загрузочное устройство с двумя манипуляторами и специальными захватами для п/п пластин
- 3 технологических модуля
  - СВЧ (2,45 ГГц)
  - ВЧ-смещение (13,56 МГц)
  - Двойной источник (СВЧ, ВЧ-смещение)
- Механическая производительность > 200 п/п пластин в час
- Компактное основание
- Низкие эксплуатационные расходы
- Система связи с цифровым управлением (Devicenet-Ethernet)
- Промышленный ПК на базе Windows

## Применение

- Удаление резиста с большой площади
- Пост-обработка после лазерной десорбции/ионизации
- Удаление не проявленного резиста
- Удаление полимера
- Удаление резиста после высокочастотной ионной имплантации
- Травление нитрида кремния/карбида кремния
- Травление TaSi
- МЭМС
- Корпусирование и тестирование (PR, PI, BCB, PBO)
- BAW/SAW ВЧ-фильтры

## Стандарты соответствия

- SEMI S2-01
- SEMI S8-01
- CE EU-RoHS
- UL (опционально)

Официальный представитель в России



«ТБС», Москва, Киевская 7

Телефон: +7 (495) 287 8577  
+7 (495) 783 0284

E-mail: info@tbs-semi.ru  
Web: www.tbs-semi.ru

[www.trymax-semiconductor.com](http://www.trymax-semiconductor.com)